

2016年2月15日

報道関係各位

新日鉄住金化学株式会社

新日鉄住金化学 第62回大河内賞「大河内記念生産特賞」を受賞

新日鉄住金化学株式会社（代表取締役社長：勝山憲夫 以下、「当社」）は、第62回（平成27年度）大河内賞において、「キャスト方式による無接着剤型銅張積層板（2層CCL）および高生産性プロセスの開発」にて「大河内記念生産特賞」を受賞しました。

大河内賞は、故大河内正敏博士の功績を記念して、大河内記念会が我が国の生産工学・高度生産方式の実施等に関する顕著な業績を表彰する伝統と権威のある賞です。

受賞案件の概要は以下のとおりです。

1980年代後半から90年代初頭にかけて、電子手帳、ノートパソコンに代表される個人向け携帯電子機器が市場に登場しましたが、当時はこれら小型電子機器に欠かせないフレキシブル回路基板（以下、「FPC」※¹）用材料は、絶縁層となるポリイミドフィルムと銅箔を、耐熱性の低いエポキシ系接着剤で張り合わせた3層タイプが主流でした。電子機器の軽薄短小化、デジタル化、カラー液晶搭載などに伴う回路の微細配線化に加え、環境規制（鉛フリー、ノンハロゲン・ノン燐）を満足する回路基板材料の実用化が望まれていました。

こうした市場ニーズに応えるために当社は、85年から無接着剤型の回路基板材料（以下、「2層CCL」※²）の開発に着手。89年、キャスト（塗工）法により低熱膨張ポリイミドを銅箔上に直接形成する全く新しいコンセプトで、接着剤を用いない2層CCLの開発に世界で初めて成功いたしました（商品名：無接着剤型銅張積層板「エスパネックス®」）。

90年には、2層CCLと銅箔との高温連続ラミネートによる「両面CCL」の開発にも成功し、携帯電子機器の市場が拡大した90年代におけるノートパソコン、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、さらには98年以降の、高機能カラー携帯電話の普及に大きく貢献しました。また、韓国や欧米の携帯端末メーカーによる高機能携帯電話の世界的普及に合わせて、生産性を高めた連続乾燥・硬化及び連続ラミネートプロセスにより実現した、業界随一の供給能力を背景に、高機能FPC向け標準材料としての地位を確立しました。

近年においては、従来型の携帯電話に代わり急速に普及が進んだスマートフォン向けに、性能・品質水準がさらに高度化した高機能FPCに不可欠な素材として、国内・外の幅広いお客様からの信頼を得ています。

「エスパネックス®」は、グローバル化した厳しい競争環境の中で、現在も世界トップシェア（約30%：当社見込み）を維持しています。

今年度は、スマートフォンの新機能搭載などにより販売が拡大し、過去最高の販売数量を見込んでおり、さらに来年度も引き続き販売数量が拡大するものと見込まれています。

当社は今後とも市場ニーズに対応した技術開発・製品開発により、各種電子機器および先端デバイスの発展に貢献してまいります。

以上

※1 FPC=Flexible Printed Circuit

※2 CCL=Copper Clad Laminate

■生産拠点：千葉県木更津市（新日鐵住金 君津製鐵所内）
福岡県北九州市（当社 九州製造所内）

■生産能力：1,200 万平方メートル／年

■販売拠点：東京本社、上海、香港、東莞、台北、ソウル

■無接着剤銅張積層板「エスパネックス®」



※本件に関するお問い合わせ先
新日鐵住金化学株式会社 総務部（広報）
03-5207-7600